



## GLPOLY XK-TN08 导热胶带

非硅导热胶带

产品简介	产品特性	典型应用
XK-TN08 是导热、电绝缘双面胶膜。具有优良的永久粘接性、高导热性和良好的绝缘性能。XK-TN08胶带是一种耐高温丙烯酸蛋压敏胶,在玻璃纤维布双面涂布高导热陶瓷填充而成。	易于组装 导热系数0.8 W/mk 高导热性丙烯酸粘合剂 用于需要电气隔离的应用 具有一般的导热性能和超高的粘接性能,使其电子元件与散 热器之间无需机械搭扣和粘接。微小压力即可粘接,其粘接 性能和粘接强度随时间、温度和压力的增加而提高.	用于粘接基板 无降压芯片 柔性电路板 大功率晶体管和散热器或其他冷却装置 PCB LED等领域

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	单位	XK-TN08	测试法
补强材		玻纤布	
颜色		白色	目视
厚度	mm	0.25	ASTM D374
密度	g/cm <sup>3</sup>	2.5	ASTM D792
体积电阻	Ωcm	>10 <sup>13</sup>	ASTM D257
热阻抗	°Cin²/W	0.43	ASTM D5470
导热 <b>系数</b>	W/mk	0.8	ASTM D5470
击 <b>穿</b> 强 <b>度</b>	KV	> 6	ASTM D149
<b>介</b> 电 <b>常数</b>	1	5	ASTM D150
粘接强度	N/in	>8	ASTM 3330
应 <b>用温度</b>	°C	-20~130	ASTM G166
拉伸强度	psi	N/A	ASTM D149
硅氧烷 D4~D20	%	0	GC-MS
伸长率	%	N/A	ASTM D149
贮存时间	Months	12	UL 746B, Viscosity method

## 特别声明:

以上所有陈述,技术信息和建议均基于本公司认为可靠的测试或经验。鉴于配方、工艺、时间、条件等的不同,许多不可控因素都可能影响产品在特定应用中的使用和性能,因此用户应做评估并根据自己的生产情况进行调整,我司不作出任何承诺。我们强烈建议您进行自己的测试试验,以确认我们产品的适用性。做司有权对自己的产品进行改进升级,其产品有任何改动,按技术状态管理程序提前通知。

**除非**另有明确约定, 否则对技术数据表中的信息或 有关产品的任何其他书面或口头建议不承担任何责任。

